

2-1-2-31 SSR 下地マジックマーク残り／SR 基底残留墨水标记／Marker pen mark on base material under solder resist

【特徴】SR印刷前の基板に付けられたマジックインクマークがSR基底に残っている状態の欠陥

【特征】SR印刷前板面塗写の墨水标记残留在SR基底的缺陷。

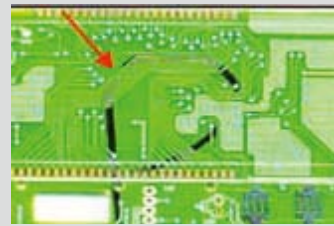
【Characteristics】A marker pen mark is left under solder resist on a board before solder resist application

【原因・判断ポイント・発生工程】回路形成後の板面に付けられたマジックインクマークがSR印刷前の整面で残り、本来なら不合格品として扱われるべきものが見逃されて出来たもの（出荷検査工程）

【原因、判断要点、发生工序】图形转移后，在表面处理时没有清除板上涂写的墨水标记。本来应该作为不合格品处理，但是，漏检而发生的（出厂检查工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

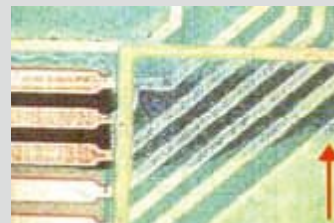
A marker pen mark put on a board surface after forming conductors is left un-removed by the surface scrubbing before solder resist application. The product should have been rejected but is overlooked. (Delivery inspection)



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率×40

【注釋】显微镜倍率×40

【Comments】Magnification: ×40

2-1-2-32 SR 下地導体傷／SR 基底的导线损伤／Scratch on the conductor under solder resist

【特徴】SR下地の導体表面に傷が残っている状態の欠陥

【特征】SR基底的导线表面有损伤的缺陷。

【Characteristics】A scratch left on the conductor surface under the solder resist

【原因・判断ポイント・発生工程】SR塗布前の回路形成済み基板の表面に何かが接触し出来たもの（回路形成後～SR印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】在SR塗布前图形转移后的板面接触某种物体而引起的（图形转移后～SR印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by a contact of an object with the conductor surface of a board after forming conductive pattern and before solder resist application (Forming conductive pattern - solder resist application)



【コメント】顕微鏡倍率×40

【注釋】显微镜倍率×40

【Comments】Magnification: ×40



【コメント】導体部及び樹脂部にも傷あり
顕微鏡倍率×30

【注釋】导线以及树脂层都有损伤
显微镜倍率×30

【Comments】Scratch on conductor area and laminate area
Magnification: ×30